

深圳莱宝高科技股份有限公司

关于签订战略合作暨第8.5代新型半导体显示器件项目的投资意向协议的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的《战略合作暨第8.5代新型半导体显示器件项目的投资意向协议》仅确立了武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下简称“东湖管委会”、“甲方”）与深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）共同建立战略合作关系暨合作投资第8.5代新型半导体显示器件项目的意向。具体的合作内容将根据双方后续工作进一步落实和推进，后续项目的合作仍需单独签订正式协议以约定具体事项，且具体投资金额及规模等尚需经政府有权机构备案批准，公司亦需根据相关法律法规规定履行相应的决策程序，实施过程中尚存在不确定性。敬请投资者谨慎投资，理性投资，注意投资风险。

2、本意向协议的签订对公司业务的独立性无重大影响；本协议是框架性的意向合作协议，具体项目合作的正式投资协议尚未签订，暂时无法预计本协议对公司本年度及以后年度经营业绩造成的影响。

3、公司不存在最近三年披露框架协议及进展未达预期的情况。

一、协议签署概况

1、协议签署基本情况

为充分运用各自的优势资源共同合作在东湖新技术开发区（以下简称“东湖高新区”）打造新型显示产业生态，同时，为积极应对公司所处行业的竞争环境变化，巩固和提升公司现有主营业务并结合长远可持续发展的需要，共同合作投资建设第8.5代新

型半导体显示器件项目（以下简称“项目”），东湖管委会与公司经友好协商，于 2020 年 10 月 29 日共同签署了《战略合作暨第 8.5 代新型半导体显示器件项目的投资意向协议》。

此协议为公司与东湖管委会签订的意向性合作协议，需经公司董事会和股东大会审议通过后才能正式生效。

2、协议签署生效尚需履行的审议决策程序

本协议属于双方合作的意向性约定，仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关的投资协议，且具体投资金额及规模等尚需经政府有权机构备案批准，公司亦将根据合作事项的后续进展情况，依据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。

二、协议签署对方情况

- 1、协议签署对方名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会
- 2、协议签署对方性质：机关
- 3、注册地：湖北省武汉市洪山区高新大道 777 号
- 4、法定代表人：陈平
- 5、统一社会信用代码：11420100010889595Y
- 6、与公司是否存在关联关系：

公司与东湖管委会不存在关联关系，本协议的签订亦不构成关联交易。公司以前年度未与东湖管委会签署过类似的框架协议。

7、其他说明：

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

东湖管委会不属于失信被执行人。

三、签署协议的主要内容

（一）战略合作

1、项目合作方

武汉东湖高新区于1988年成立，陆续被批准为首批国家级高新区、第二个国家自主创新示范区、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区，先后获批国家光电子信息产业基

地、国家生物产业基地、央企集中建设人才基地、国家首批双创示范基地、国家存储器基地，在新型显示领域拥有雄厚的产业基础，聚集了多条显示面板产线及上下游相关产业链企业。

公司是专业研发和生产平板显示器件及上游材料、触控器件的龙头厂商，成立于1992年，公司产品广泛应用于平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机、车载仪器仪表、医疗、工业控制面板等领域。

2、项目合作内容

鉴于甲乙双方在新型显示领域具有良好的合作基础和广泛的合作前景，双方拟共同在武汉东湖高新区就培育和引进新型显示面板的上游材料、设备和下游终端企业开展战略合作，形成产业聚集。

3、合作方式

乙方负责推荐新型显示产业链上游优质材料、设备以及下游终端制造相关企业落户武汉东湖高新区；甲方积极争取引进上述企业，同时在法律法规范围内，为拟落户企业提供相关优惠政策及发展用地，配合乙方实现本地化配套，降低相关生产成本。

（二）第8.5代新型半导体显示器件项目

1、合作投资项目概述

（1）乙方与甲方指定的投资主体共同合资在东湖高新区注册成立项目公司（以下简称“项目公司”），作为项目投资建设及运营主体，建设第8.5代新型半导体显示器件项目。

（2）该项目拟采用IPS TFT（平面内转换薄膜晶体管）、氧化物半导体TFT技术等显示技术，计划在东湖高新区建设一条第8.5代TFT-LCD面板及模组生产线。项目计划总投资115亿元（币种为人民币，下同；此处为估算数额，准确投资额以实际投资为准），设计产能6万片/月的第8.5代TFT-LCD面板（基板规格：2200mm*2500mm）、100万块/月的TFT-LCM模组；产品主要应用于笔记本电脑、车载仪器仪表、医疗/工控仪器仪表、户外公共显示等。

（3）项目投产后，项目公司后续规划新增投资约15亿元人民币（此处为估算数额，准确投资额以实际投资为准），将产能扩充至8万片/月第8.5代TFT-LCD面板、250万块/月TFT-LCM模组。

2、投资项目合作方式

(1) 项目公司注册资本 65 亿元，甲方投资主体和乙方各出资 32.5 亿元，各持项目公司 50% 股权。乙方出资的 32.5 亿元，由其自筹 20 亿元，另外 12.5 亿元由甲方投资主体向乙方提供优惠借款；乙方需为该借款向甲方投资主体提供经甲方认可的担保（担保物的价值应不低于借款本金的 120%）。

(2) 甲方积极协调银行等金融机构向项目公司提供贷款不超过 35 亿元。项目公司的 35 亿元银团贷款如需股东提供担保时，由甲方投资主体和乙方按其在项目公司的股权比例提供担保。

(3) 甲方投资主体有权要求乙方在 2025 年 12 月 31 日前启动还款，并于 2027 年 12 月 31 日前完成对甲方投资主体所持项目公司股权的回购和偿清全部借款，具体回购事宜由双方另行协商。

3、甲方承诺

(1) 甲方将为项目公司提供研发补贴、贷款贴息、员工住宿等法律法规许可范围内的优惠政策。

(2) 根据项目实际情况，甲方将依法依规在东湖高新区内为本项目提供约 700 亩工业用地，由国土管理部门通过招标、拍卖、挂牌方式公开出让，项目公司有权参与项目用地的竞买。项目用地由甲方负责完成“七通一平”（通水、通电、通气、通路、通信、通有线、通宽带、土地平整）。

(3) 在国家政策允许范围内，积极协助项目公司办理工商、税务、规划、建设等行政审批相关手续，为项目提供优质服务。

4、乙方承诺

(1) 乙方承诺按本协议约定进行投资、建设、经营，加快项目立项、环评等各项报批工作，确保项目按计划进度建设、投产、达产。

(2) 乙方保证项目公司遵守国家法律法规，依法依规开展项目建设及运营。

5、其他重要条款

(1) 本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章并经甲、乙双方各自有权决策机构批准后生效。

(2) 本协议签署后，甲、乙双方将积极推动项目落地，并就项目合作具体事宜签

订正式合作协议，本协议与正式合作协议条款如有冲突，以正式合作协议约定为准。

四、对公司的影响

本意向协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。本意向协议仅为框架性的战略合作暨投资意向协议，具体的合作内容将根据双方后续工作进一步落实和推进，具体合作投资协议尚未签订，对公司具体业务的影响将取决于后续项目的实施和执行情况，暂时无法预计本协议对公司本年度及以后年度经营业绩造成的影响。

五、风险提示

1、本协议仅为协议双方形成的框架意愿性约定，具体的合作内容将根据双方后续工作进一步落实和推进，项目的具体投资金额及规模亦需经政府有权机构备案批准，具体合作投资协议的签订时间、具体投资金额及实际执行金额尚存在重大不确定性的风险。

2、对于本协议涉及事项的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

3、公司不存在最近三年披露框架协议及进展未达预期的情况。

4、敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

武汉东湖新技术开发区管理委员会与深圳莱宝高科技股份有限公司共同签署的《战略合作暨第 8.5 代新型半导体显示器件项目的投资意向协议》

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日